

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



## 投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员名称	天风证券 文毓；华夏基金 杨雅昭；混沌投资 谭力博；鹏扬基金 许颖婕；华福证券 孟鹏飞；宝盈基金 唐叶
时间	2026年5月7日
地点	深圳市福田区益田路4088号
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书：钟科先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问公司主营业务及核心产品是什么？有给哪些客户供应产品？</b></p> <p>答：公司系国家级高新技术企业，深耕电子新材料领域，集研发、生产、销售于一体，核心聚焦电子装联材料，主营产品涵盖微电子焊接材料与微电子辅助焊接材料，核心产品为锡膏、锡条、锡线、助焊剂、清洗剂等。</p> <p>公司在国内微电子焊接材料领域居于领先地位，公司当前已与国内众多知名客户建立合作关系其中通讯行业代表客户如中兴通讯（ZTE）、华为、TCL 通讯；显示与照明行业代表客户如冠捷科技、艾比森、利亚德；家电行业代表客户如格力电器、海尔集团、海信集团、美的；光伏行业代表客户如通威股份、爱旭股份、阳光电源；汽车电子行业代表客户如比亚迪、华阳通用、</p>

中车时代；消费电子行业代表客户如大疆、传音控股、小米；电子类代表客户如公牛集团、奥海科技、航嘉电子；安防行业代表客户如海康威视、茂佳科技等国内知名企业。此外，公司还通过富士康、捷普电子等大型 EMS 厂商，间接服务惠普、戴尔、亚马逊等国际知名终端品牌客户。

## **2、公司今年的分红计划如何？未来能否继续维持高分红比例？**

答：公司 2025 年度利润分配方案为：以现有总股本 124,520,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股（本事项尚需提交公司股东会审议）。公司自上市以来累计现金分红已超 1.9 亿元，年度分红总额占归母净利润的比例从 2022 年至 2024 年依次为 49.63%、80.36%和 76.12%。

公司未来将继续优化股东回报机制，以优异的经营业绩持续回馈投资者，与广大股东共享企业成长红利，实现公司与股东的可持续的共赢发展。有关内容请持续关注公司于巨潮资讯网披露的相关内容。

## **3、请问公司的核心竞争优势有哪些？**

答：唯特偶在国内微电子焊接材料领域稳居领先地位，尤其在锡膏、助焊剂两大细分赛道优势突出。公司的核心竞争力主要体现在三方面：（1）技术优势。自创立 28 年来，公司始终紧跟行业技术发展趋势，不仅实现产品品类的全面覆盖，更积累了丰厚的技术储备，在产品性能稳定性保障、生产成本精细化控制等关键环节均处于行业前列；（2）客户资源优势。公司迄今合作客户累计超 4000 家。由于微电子焊接材料行业存在较长的认证周期与较高的市场进入门槛，客户黏性极强，能够为公司持续贡献稳定的营业收入；（3）规模优势。公司上市以来，公司资金实力与人才储备显著增强，整体规模稳居国内同行业优势地位。

依托充足的资金与人才支撑，公司不断赋能研发创新、生产效率提升与管理优化，尤其在生产成本控制、研产销协同效率、市场定价话语权等方面，优势愈发凸显。

**4、作为龙头企业，请问公司在国产替代方面的计划和成就？**

答：面对国际形势变化，国产替代已成为产业升级的必然趋势，下游客户对国产材料的接纳与应用意愿持续增强。公司通过持续加大研发投入，部分核心产品性能已达到国际先进水平，成功实现对国外同类产品的替代。这些产品已应用于半导体、汽车电子、储能、新能源、AI 算力等关键领域，同时帮助公司建立了品牌影响力，占据了相应的市场份额。公司将继续聚焦技术突破，进一步提升产品的稳定性与性价比；同时深化与下游客户的合作，推动国产材料更广泛地融入客户的研发与生产流程，加速全产业链的国产替代进程。

**5、请问公司产品在光模块领域是否有应用？有哪些客户？**

答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如 TOSA、ROSA）的 SMT 贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是 PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。

附件（如有）	
日期	2026 年 5 月 7 日